

6月市场洞察报告

半导体市场分析与趋势展望

“DISTINCTIVE
INSIGHTS,
INFORMED
DECISION-MAKING”

洞察行情 精准决策

序言

本报告由安芯易电子商务（深圳）有限公司推出，旨在为客户、供应商及合作伙伴提供半导体行业资讯及市场趋势预测，报告涵盖宏观动态、半导体产业动态、终端市场动态、重点产品行情等模块，助力行情洞察、精准决策。

本报告每月更新，可关注安芯易电子微信公众号，及时获取报告发布等信息。您也可以通过联系安芯易客户经理获取完整版报告。

目录

摘要 4

一、宏观动态 6

 （一） 行业政策 6

 （二） 经济指数 8

二、半导体产业动态 13

 厂商动态深度解读 14

三、 终端市场动态 21

 （一） 人工智能 23

 （二） 汽车 24

 （三） 工业 25

 （四） 机器人 26

四、 存储行情 28

 （一） 存储行情概览 28

 （二） 各存储品牌现货市场价格走势 28

信息来源 36

免责声明 41

摘要

2026 年 6 月重点行情趋势	
宏观动态	● WSTS 春季预测：2026 年全球半导体市场规模预计达 1.51 万亿美元，同比增长 89.9% ● 美国：AI 芯片出口管制与算力基建投资并行，供应链合规门槛显著提升 ● 欧盟：发布技术主权一揽子计划，荷兰同日加入 Pax Silica 联盟 ● 韩国：公布“三大超级项目”，半导体领域投资 800 万亿韩元打造非首都圈产业集群 ● 中国：工信部印发《“人工智能+信息通信”创新发展实施意见》
产业动态	● MLCC 市场：史诗级缺货潮来袭，AI 与新能源车双线驱动 ● 意法半导体：三个月内二度涨价，产业链涨价压力持续传导 ● 德州仪器：7 月 1 日新价生效，模拟 IC 涨价周期确立 ● 英飞凌：7 月 1 日二度涨价，AI 驱动功率半导体结构性短缺 ● 恩智浦：6 月 1 日涨价落地，需求回暖但整体仍疲软 ● 微芯科技：8 月涨价函与看空报告并行，MCU 涨价潮全面确立 ● 国巨：7 月 1 日起全系列电容产品涨价，被动元件涨价潮全面扩散 ● 亚德诺：Q2 财报超预期，AI 需求驱动估值持续攀升 ● 博通：携手 OpenAI 发布首款自研 AI 芯片，AI 半导体业务持续高增 ● 瑞萨电子：收购 Pictorus 加速嵌入式系统开发战略 ● 联发科技：向客户发出正式涨价函，启动价格调整机制 ● 瑞昱：7 月起针对特定产品线调涨超 10% ● 扬杰科技：年内第二轮涨价落地，欧洲市场采购资格延续 ● 台积电/英伟达：GTC Taipei 宣布 AI 深度合作，黄仁勋亲赴 COMPUTEX 释放多重信号 ● 晶圆代工行业：全面进入涨价上行周期
终端市场	人工智能 ● Meta 寻求新融资以扩建 AI 基础设施 ● AWS 加码投资印度 AI 及云端基础设施 ● 腾讯向长鑫存储下达 200 亿元 DRAM 订单 汽车 ● BMW 完成在美国的 17 亿美元电动车生产投资 ● 比亚迪瞄准全球最大汽车制造商地位 ● Jeep 扩大欧洲电动化布局 工业 ● 霍尼韦尔瞄准工业自动化领域并购机会 ● 施耐德电气拟以 31 亿美元收购 Cognite ● 埃森哲扩大与西门子的工业 AI 合作 ● 西门子推进软件定义工业自动化发展

	机器人 ● Appttronik 启用 Robot Park，并发布 Apollo 2 人形机器人 ● 宇树科技持续推进 IPO 计划并扩大人形机器人产能 ● Agility Robotics 计划通过 SPAC 合并上市
存储行情	● DDR4：供应持续收紧，价格高位运行，整体稳中偏强。 ● DDR5：需求旺盛叠加供给不足，合约价连续多月大涨，市场处于供不应求状态。 ● LPDDR5：价格高位，移动端承压。 ● NAND Flash：二季度合约价预计大幅上涨，NOR Flash、SLC NAND 上半年涨幅均超一倍。 ● SSD：终端零售价较年初大幅攀升，铠侠推出 PCIe 5.0 高端新品。 ● HDD：批发价连续第五季度上涨，均价相较基准已翻倍，涨势未见放缓。

一、宏观动态

（一）行业政策

- **WSTS 春季预测：2026 年全球半导体市场规模预计达 1.51 万亿美元，同比增长 89.9%**

6 月 2 日，世界半导体贸易统计组织（WSTS）发布 2026 年春季半导体市场预测报告，预计 2026 年全球半导体市场规模将达 1.5112 万亿美元，同比增长 89.9%，创历史最高纪录。WSTS 曾在 2025 年 12 月预测 2026 年市场规模为 9754 亿美元（同比增长 26.3%），鉴于数据中心普及速度超出预期，该机构大幅上调了预测。增长主要由存储芯片领域主导，2026 年存储芯片销售额预计同比骤增约 249.5%至 8039 亿美元，AI 基础设施、高带宽存储器（HBM）及加速计算平台的持续强劲需求是核心驱动力；逻辑芯片预计同比增长 37.3%至 4113 亿美元；微处理器、模拟芯片、分立半导体、传感器与光电子器件分别增长 20%、10%、8%和 3%。区域方面，美洲地区以 112%的同比增速领跑全球，亚太地区增长 87%，欧洲和日本分别增长 58%和 28%。展望 2027 年，WSTS 预测全球半导体市场将进一步增长约 27%至 1.9 万亿美元，存储芯片和逻辑芯片分别增长 32%和 27%。

- **美国：AI 芯片出口管制与算力基建投资并行，供应链合规门槛显著提升**

5 月 31 日，美国商务部工业与安全局（BIS）发布出口管制新指引，明确向总部位于中国或中国澳门的实体出口先进 AI 芯片，无论该实体注册于何处，均须事先获得出口许可证，审查政策为“推定拒绝”，受影响产品涵盖英伟达 Rubin、Blackwell 系列及 AMD MI350X 等高端 AI 加速器。出口商须穿透核查买方最终母公司所在地，合规尽职调查要求显著趋严。与此同时，BIS 对 H200 和 AMD MI325X 保留了有限的“逐案审查”通道，适用芯片须满足总处理性能低于 21,000 等技术门槛，且须同时满足多项条件，包括对华出口总算力不得超过对美出口总算力的 50%、芯片须经美国第三方实验室检测、采购成本增加 25%等，此外逐案审查仅适用于从美国直接出口。算力基建方面，Coherent 获《芯片法案》5000 万美元补贴扩建得州磷化铟晶圆厂，产能将提升四倍；OpenAI 与博通联合发布首款定制推理芯片 Jalapeño。整体来看，美国在收紧对华 AI 芯片出口管制的同时加速本土算力基建投资，管制逻辑从“产品流动控制”向“能力获取控制”延伸，供应链合规门槛显著提升。

- **欧盟：发布技术主权一揽子计划，荷兰同日加入 Pax Silica 联盟**

6 月 3 日，欧盟委员会正式发布欧洲技术主权一揽子计划，核心包含《芯片法案 2.0》与《云与人工智能发展法案》两项立法提案。《芯片法案 2.0》实现两大转向：从供给驱动转向需求拉动，着力通过公共采购优先欧洲产品、促进电信与国防等行业对接芯片制造商等方式提振本地需求——欧洲审计院已将欧盟 2030 年全球芯片产能占比预期从 20%下调至不足 12%；首次允许欧盟委员会

直接投资大型跨境项目，计划到 2035 年动员约 1200 亿欧元资金，并在 2030 至 2033 年间筹建首座先进制程晶圆制造试产线。《云与人工智能发展法案》提出五至七年内将欧洲数据中心容量提升三倍，引入统一主权评估框架，明确由于美国《云法案》允许美执法机构调取美企境外存储数据，美企将难以获得最高主权等级认证。6 月 23 日，荷兰贸易部长斯约尔茨马在华盛顿签署协议，正式加入美国主导的“Pax Silica”AI 供应链联盟（韩国、日本已率先加入，欧盟预计未来也将加入）。斯约尔茨马此行同时就美国拟议的“MATCH 法案”展开游说，明确表示美荷目标一致，但“法案中的某些条款暗示美国可能单方面掌控涉及荷兰国家安全及企业运营的决策权”，若合作“演变为强制不可取”。目前美荷已就限制 ASML 对华出口最先进光刻机达成一致，但在是否允许其向中国客户出售及服务部分次先进设备的问题上仍存分歧。荷兰加入 Pax Silica 恰逢其 7 月初计划率贸易代表团访华前夕，凸显荷兰在中美科技博弈中的两难处境。一揽子计划尚待欧洲议会与理事会审议，行业已出现本地化含量要求可能碎片化供应链的担忧。

● 韩国：公布“三大超级项目”，半导体领域投资 800 万亿韩元打造非首都圈产业集群

6 月 29 日，韩国总统李在明在青瓦台主持召开“大韩民国大飞跃三大超级项目国民报告会”，正式公布国家级产业战略。“三大超级项目”涵盖半导体、物理 AI 及 AI 数据中心三大支柱。半导体方面，三星电子与 SK 海力士将在西南地区（光州等）共投资 800 万亿韩元（约合 3.53 万亿元人民币），分别兴建两座存储晶圆制造厂，投资规模创韩国民营企业历史之最，超出韩国政府 2026 年全年预算（约 728 万亿韩元）。两大巨头还计划在忠清地区修建大规模 HBM 晶圆厂，在东南圈和大庆圈建设半导体材料、零部件及装备生产线。物理 AI 方面，政府将加速制造业 AI 转型，每年推广千台以上行业专用机器人，并在新万金兴建机器人代工厂。AI 数据中心方面，SK 集团、GS 集团与 NAVER 将在 2029 年前联合筹资约 550 万亿韩元建设总容量 8.4GW 的数据中心，至 2035 年累计投资 1000 万亿韩元以上、总容量达 18.4GW。作为“三大超级项目”的技术攻关配套，韩国政府同步启动“超级创新经济项目”，投入 5000 亿韩元（约合 3.29 亿美元）国家资金专项攻关下一代功率半导体技术，重点围绕氮化镓（GaN）和碳化硅（SiC）等宽禁带半导体材料，计划 2027 年实现 1200V 碳化硅 MOSFET 量产，至 2030 年将功率半导体自给率提升至当前水平的两倍。该计划标志着韩国半导体产业从“京畿道单核”向“西南地区第二核”的战略迁移正式启动。

● 中国：工信部印发《“人工智能+信息通信”创新发展实施意见》

6 月 10 日，工业和信息化部印发《“人工智能+信息通信”创新发展实施意见（2026—2028 年）》。意见明确提出加强高端光电芯片和器件研发，要求加强高速光电芯片、高速转发/交换芯片、全光交换器件、光电共封装器件等技术和产品研发验证，开展光电混合组网技术试验，加速技术方案成熟。意见还要求加强智算超节点光电互联技术攻关，开展智算网络技术与产品验证。该政策将光电芯片、光电路交换器件、共封装光学器件等视作 AI 发展底座。

(二) 经济指数

● 5 月全球制造业 PMI 持平于 52.6，产出增速创近五年新高但需求可持续性存疑

2026 年 5 月，全球制造业连续第十个月保持扩张。摩根大通全球制造业 PMI 录得 52.6，与 4 月持平，产出增速创 2021 年 7 月以来最快，新订单连续第五个月增长，增速接近 4 月创下的 50 个月高点，但扩张动能的可持续性面临考验——增长主要由客户为规避预期中的价格上涨和供应中断而提前采购、主动补库所驱动，投入品价格涨幅为近四年来最大，供应商交货时间恶化至 2022 年 8 月以来最严重程度，企业乐观情绪降至七个月低点。分区域看，美国 PMI 升至 55.1，创 2022 年 5 月以来新高，产出增速为四年多来最快，但出口订单连续第 11 个月下滑，地缘政治不稳与关税因素持续压制外需；欧元区 PMI 从 4 月近四年高点的 52.2 回落至 51.6，新订单陷入停滞，出口订单亦现下滑，投入成本创 2022 年 5 月以来最大涨幅，产出价格涨幅创三年半新高，供应链延误恶化至 2022 年 6 月以来最严重程度；日本 PMI 从 4 月 51 个月高点的 55.1 降至 54.5，连续第五个月扩张，新出口订单增速创 2021 年 5 月以来最快，投入成本涨幅为 2022 年 9 月以来最大；中国 PMI 录得 51.8，连续第六个月扩张，新订单增速仍处过去五年来最高水平之一，但新出口订单轻微下滑，通胀压力明显缓解，投入品购进价格与产成品销售价格分别在六个月和七个月来首次环比下降；韩国 PMI 升至 54.8，创 2021 年 3 月以来最高，产出与新订单增速均触及近五年峰值，但新出口订单六个月来首次下滑，投入成本通胀维持接近历史高位；印度 PMI 终值录得 55.0，创三个月新高，国内需求提供主要支撑，新出口订单增速较 4 月有所放缓但仍保持稳健，投入成本通胀仍处近四年来最强水平之一。整体来看，2026 年 5 月全球制造业在 AI 相关需求与预防性补库的双重驱动下保持扩张，但中东冲突引发的供应链紊乱与成本上行压力持续加剧，各主要经济体分化明显，全球制造业正面临“扩张延续”与“可持续性存疑”之间的微妙平衡。

全球各地区制造业 PMI

时间	全球	中国	日本	韩国	印度	美国	欧元区
2023-11	49.30	49.40	48.30	50.00	56.00	46.70	44.20
2023-12	49.00	49.00	47.90	49.90	54.90	47.40	44.40
2024-01	50.00	49.20	48.00	51.20	56.50	49.10	46.60
2024-02	50.30	49.10	47.20	50.70	56.90	47.80	46.50
2024-03	50.60	50.80	48.20	49.80	59.10	50.30	46.10
2024-04	50.30	50.40	49.60	49.40	58.80	49.20	45.70
2024-05	50.90	49.50	50.40	51.60	57.50	48.70	47.30
2024-06	49.50	49.50	50.00	52.00	58.30	51.70	45.60
2024-07	49.80	49.40	49.10	51.40	58.10	46.80	45.80
2024-08	48.90	49.10	49.80	51.90	57.50	47.20	45.60
2024-09	48.80	49.80	49.70	48.30	56.50	47.20	45.00
2024-10	48.80	50.10	49.80	48.30	57.50	46.50	46.00
2024-11	50.00	50.30	49.00	50.60	56.50	48.40	45.20

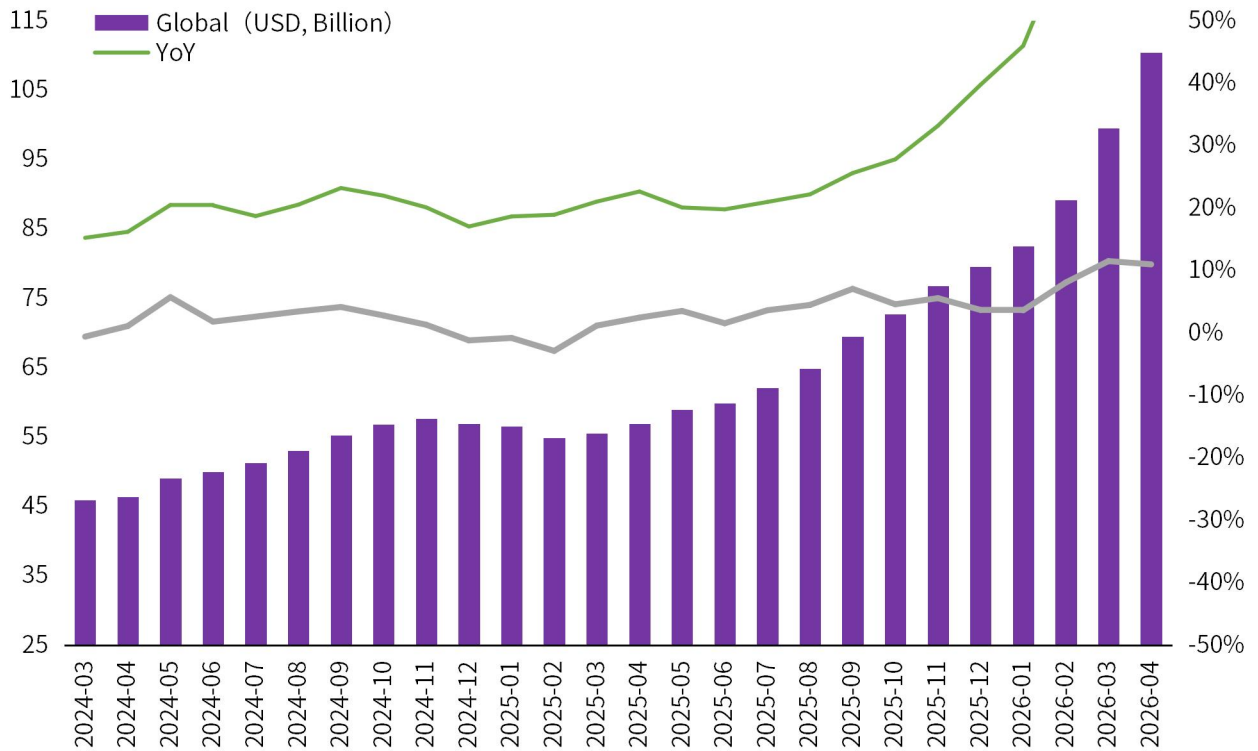
2024-12	49.60	50.10	49.60	49.00	56.40	49.20	45.10
2025-1	50.10	49.10	48.70	50.30	57.70	50.90	46.60
2025-2	50.60	50.20	49.00	49.90	56.30	50.30	47.60
2025-3	50.30	50.50	48.40	49.10	58.10	49.00	48.60
2025-4	49.80	49.00	48.70	47.50	58.20	48.70	49.00
2025-5	49.60	49.50	49.40	47.70	57.60	48.50	49.50
2025-6	50.30	49.70	50.10	48.70	58.40	49.00	50.50
2025-7	49.70	49.30	49.90	48.00	59.20	48.00	49.80
2025-8	50.90	50.50	52.00	48.30	59.30	53.00	50.70
2025-9	50.70	51.20	48.50	50.70	57.70	52.00	49.80
2025-10	50.90	50.60	48.20	49.40	59.20	52.50	50.00
2025-11	50.50	49.90	48.70	49.40	56.60	52.20	49.60
2025-12	50.40	50.10	50.00	50.10	55.00	51.80	48.80
2026-01	50.90	50.30	51.50	51.20	55.40	52.40	49.50
2026-02	51.80	52.10	53.00	51.10	56.90	51.60	50.80
2026-03	51.30	50.80	51.60	52.60	53.90	52.30	51.60
2026-04	52.60	52.20	55.10	53.60	54.70	54.50	52.20
2026-05	52.60	50.00	54.50	54.80	55.00	55.10	51.60

数据来源：Wind

● 全球半导体销售额：4 月环比增长 11%至 1105 亿美元，年增幅达 93.9%

2026 年 6 月 5 日，半导体工业协会 (SIA) 公布数据显示，2026 年 4 月全球半导体销售额达 1105 亿美元，较 3 月的 995 亿美元环比增长 11%，较 2025 年 4 月的 569 亿美元同比大幅增长 93.9%，连续第 14 个月实现环比增长。SIA 总裁兼首席执行官 John Neuffer 表示，全球半导体市场持续录得强劲的同比增速，主要受亚太、美洲及中国市场销售拉动。区域表现方面，4 月同比涨幅中，美洲领涨 115.8%，亚太/其他地区增长 114.9%，中国增长 78.6%，欧洲增长 54.7%，日本增长 15.6%；环比涨幅中，美洲增长 16.7%，亚太/其他地区增长 8.7%，中国增长 8.0%，欧洲增长 6.7%，日本增长 6.4%。SIA 同步认可 WSTS 春季全球半导体销售预测，2026 年全球年销售额预计将增长 90% 至 1.5 万亿美元，较此前预期更早达成里程碑；2027 年全球销售额预计将突破 1.9 万亿美元。需求增长主要来自 AI 基础设施与加速计算平台的持续部署。SIA 同时呼吁美国政策制定者推动有利于美国在全球半导体扩张中占据创新与增长份额的产业政策，以支撑经济竞争力与国家安全。

全球半导体销售额（十亿美元）

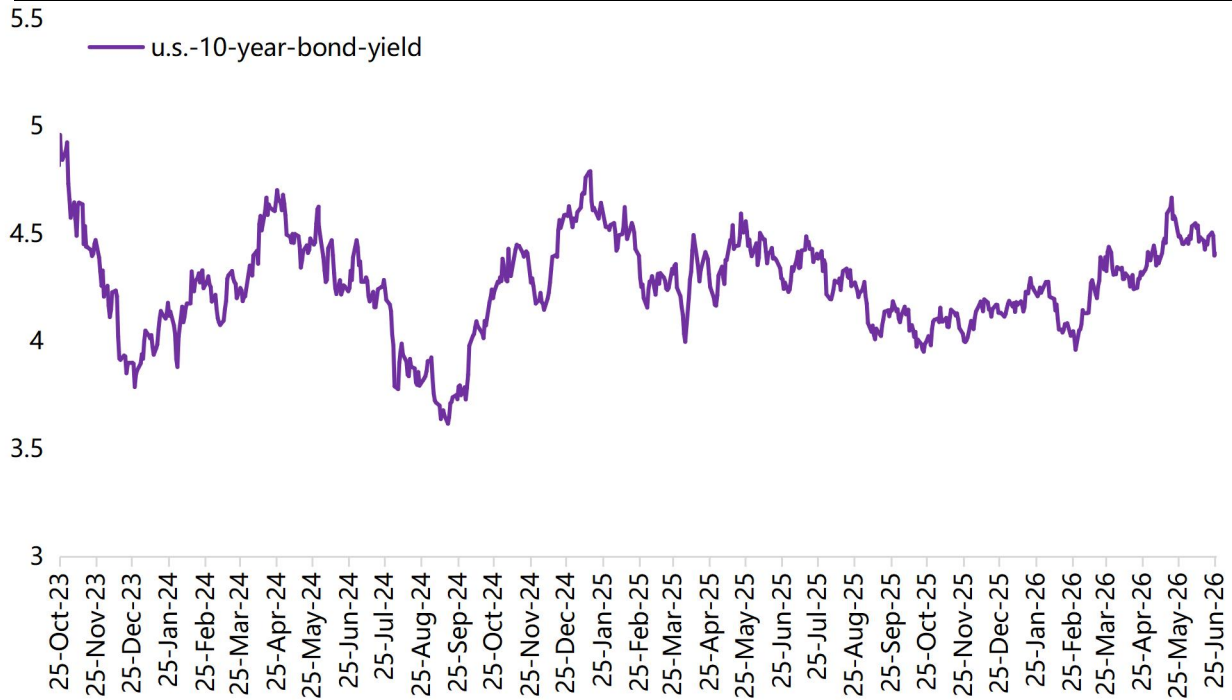


数据来源：SIA

● 6月美国10年期国债利率冲高回落，鹰派政策信号与地缘风险缓和交替主导

2026年6月，美国10年期国债收益率呈现冲高回落态势，月初收于4.477%，月末收于4.409%，累计下行约6.8个基点，月内波动区间约4.39%-4.58%。6月上旬，5月非农就业数据超预期强劲（新增就业17.2万人，近乎市场预期的两倍）推动收益率震荡上行至4.55%一线；6月10日美国5月CPI同比升至4.2%、创近三年新高，但核心CPI环比仅涨0.21%低于预期，收益率反应温和。6月16日至18日美联储议息会议成为关键分水岭——FOMC维持利率在3.50%-3.75%不变（连续第四次按兵不动），但点阵图显著转鹰，18位官员中9人支持年内加息，2026年底利率中位数从3.4%上修至3.8%，PCE通胀预期从2.7%大幅上调至3.6%，这是美联储自2025年以来首次将利率预期从降息转向加息。受此影响，短端利率上行更为明显，2年期与10年期利差收窄至约27个基点，收益率曲线明显走平。6月下旬，美伊技术谈判恢复推动油价回落、地缘风险出现缓和迹象，叠加避险资金涌入，6月24日10年期收益率重挫10.5个基点至4.394%，创5月11日以来最低。整体而言，6月10年期收益率中枢较5月基本持平，但月内波动显著加剧；加息预期的回归意味着宏观流动性环境正边际收紧，对半导体等成长型资产的估值构成一定压力。

美国 10 年期国债利率(%)

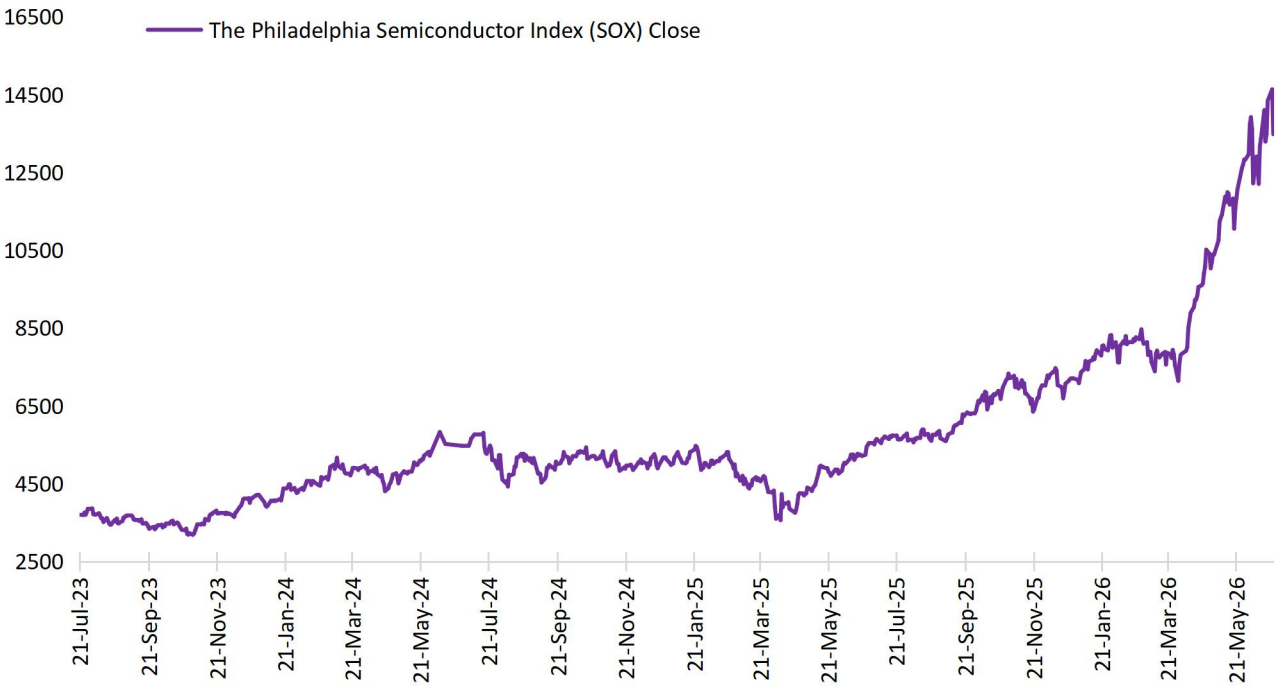


数据来源: Investing

● 5 月费城半导体指数 (SOX) 走势分析: 突破 12000 点延续强势, 月中震荡加剧但 AI 主线未改

2026 年 5 月, 费城半导体指数 (SOX) 延续上行趋势, 从 4 月末的 10,387.84 点起步, 5 月 29 日收于 12,829.38 点, 月度累计涨幅约 23.5%。月初指数加速上攻, 5 月 1 日以 10,388.82 点开盘后持续走高, 5 月 11 日盘中触及 12,108.67 点的阶段高位, 随后出现技术性回调, 5 月 12 日收于 11,741.47 点, 5 月 19 日进一步下探至 11,053.99 点, 回吐部分涨幅; 下半月指数重拾升势, 5 月 22 日收于 12,070.17 点重返 12000 点上方, 5 月 26 日收于 12,616.63 点, 5 月 29 日以 12,829.38 点报收, 盘中触及 13,115.28 点的月内高点。全月波动率明显上升, 多空博弈加剧, 但整体上行趋势未改。本轮上涨的核心驱动力依然是 AI 算力需求持续超预期: 英伟达 H200 芯片对华出口许可已获美方批准 (有待中方采购放行)、台积电 2nm 制程进展顺利、全球 AI 服务器订单饱满等利好因素不断释放。与此同时, 美国 10 年期国债收益率在 4.3%-4.6% 区间震荡, 未对高估值科技板块形成明显压制。短期快速上涨后积累的回调压力在月中得到部分释放, 但全球半导体行业在 AI 需求、先进制程推进及库存回补的多重支撑下, 景气度仍处上行通道。市场需关注后续美联储政策信号及中美半导体博弈进展对指数走势的潜在影响。

费城半导体指数(SOX)



数据来源: MacroMicro

二、半导体产业动态

半导体产业动态概览			
厂商	动态事件	关键数据	趋势/影响（含具体型号）
MLCC 市场	村田、太阳诱电、三星电机等全球头部厂商集体涨价	村田 47μF 产品从 0.2 元涨至 0.65 元；高端产品交期延长至 20 周以上	AI 服务器+新能源汽车双线驱动；深圳华强北出现“半小时报一次价”现象
意法半导体 STMicroelectronics	6 月 28 日起执行年内第二次全产品线涨价	两次调价间隔仅约两个月；Q1 营收同比增长 23.0%	涵盖 STM32 系列 MCU、功率 MOSFET（STP 系列）、IGBT 及 SiC 功率器件（SCT 系列）等核心品类；AI 需求外溢与成本推升双轮驱动
德州仪器 Texas Instruments	5 月 7 日发布调价通知，7 月 1 日新价生效；2025 年至今已实施四轮调价	2026 年 4 月涨幅 15%-85%；7 月新一轮涨价落地	涉及 PMIC、MOSFET、数字隔离器等核心产品；AI 服务器需求传导+铜价高位+晶圆代工涨价多重驱动；模拟 IC 涨价周期全面确立
英飞凌 Infineon	7 月 1 日起执行年内第二轮涨价	5 月 26 日发布调价通知；继 4 月首轮提价后再次上调	功率器件高位持稳，车规级 HV MOSFET 及 SiC 器件溢价最高达 30%-50%；AI 驱动功率半导体结构性短缺持续
恩智浦 NXP	6 月 1 日起实施价格调整	5 月 1 日通知客户，6 月 1 日正式执行	通胀性成本压力涵盖原材料、能源、劳动力、物流及供应商投入；i.MX 系列和部分停产料需求较多
微芯科技 Microchip	6 月 29 日发布涨价函（8 月 14 日生效）；J Capital Research 发布看空报告	未披露具体涨幅；数据中心销售额 3.027 亿美元，远低于 Marvell（40 亿美元）和博通（200 亿美元）	部分精选 MCU 及模拟 IC 产品调价；原材料、人力、物流、能源及晶圆代工成本上涨驱动；数据中心业务预计今年增长 67%，但规模远逊于竞争对手；MCU 供应严重吃紧
国巨 YAGEO	7 月 1 日起上调全系列电容产品价格	覆盖国巨约 50%营收；原厂涨幅约 50%	涵盖 MLCC、铝电解电容、钽质电容、高分子铝电容、薄膜电容及超级电容；涨价对象首次纳入直接客户（EMS/OEM），现货价与合约价同步调涨
亚德诺 Analog Devices	Q2 财报超预期，股价创历史新高	Q2 营收 36.2 亿美元，EPS \$3.09 超预期；6 月股价涨 7.64%，年初至今涨 64.26%	汽车业务是本学期重要支撑；AI 基础设施需求乐观情绪提振板块

博通 Broadcom	携手 OpenAI 发布首款定制 AI 芯片 “Jalapeño”	AI 半导体业务 Q2 收入 108 亿美元，同比+143%；2026 财年预计约 560 亿美元	定位大语言模型“推理”处理器；与 Celestica 负责工业化落地，计划 2026 年底启动吉瓦级数据中心部署
瑞萨电子 Renesas	完成对 Pictorus 的收购	收购云端行为建模平台；提升 Renesas 365 平台价值	加速嵌入式系统开发，推动从 PCB 设计到算法仿真的云端“全家桶”战
联发科技 MediaTek	向客户发出正式涨价函	涨幅约 10%-15%，涵盖手机芯片、PMIC 等多项产品	总经理暨营运长具名发函，为近年来首次以函文方式启动价格调整机制
瑞昱 Realtek	7 月起针对特定产品线调价	特定产品线调涨超 10%	涵盖网通、连接、消费性及部分特殊规格芯片；受益于 Wi-Fi、以太网、交换机需求改善及 AI PC 带动规格升级
扬杰科技 Yangjie Technology	6 月 23 日发布年内第二轮涨价函	全系列产品上调 10%-15%，7 月 1 日起执行	涵盖二三极管/晶闸管/MOSFET/IGBT/SiC 全品类；获欧盟 9 个月豁免期，欧洲客户可正常采购
台积电/英伟达 TSMC/NVIDIA	GTC Taipei 联合宣布将英伟达加速计算与 AI 技术全面引入台积电晶圆厂	光刻成本预计降 50%；台积电 3nm 月产能扩至 16-17.5 万片仍供不应求	从计算光刻、晶体管仿真到缺陷检测和工厂运营全流程优化；深化“AI 半导体三角联盟”全球供应链关键地位
晶圆代工行业	台积电、联电、世界先进、力积电等 2H26 起陆续涨价	涨幅有望延续至 2027 年，整体代工报价进入上行周期	联电规划 2026 下半年针对性涨价、2027 年大范围议价；世界先进已宣布涨价并获客户接受

厂商动态深度解读

● MLCC 市场：史诗级缺货潮来袭，AI 与新能源车双线驱动

MLCC 市场正经历一轮史诗级缺货潮。受惠于 AI 服务器与新能源汽车需求高涨，深圳华强北市场 MLCC 报价波动剧烈，出现“半小时报一次价”的现象，高电容值产品严重缺货，部分高端产品交期大幅延长至 20 周以上。以村田制作所一款 47μF 容值产品为例，单颗价格已从 0.2 元以下飙升至 0.65 元；三星电机产品同样价格狂飙，原价 100 多元的单卷产品已涨至 400-500 元。

从需求端来看，AI 服务器升级为机柜级高密度计算平台，其 MLCC 用量较传统服务器高出 8-10 倍。随着英伟达等企业 AI 芯片需求升级，单机柜 MLCC 价值已从 H100 的 3000 美元大幅攀升至 GB200 的 1.2 万美元；未来 Rubin Ultra 量产时更有望达到 4 万美元，单机柜 MLCC 用量从 1.5 万颗激增至 9 万颗以上。汽车电子同样成为重要增量市场——纯电动车平均 MLCC 用量约为传统燃油车的 6 倍。

供给端方面，由于 AI 高容 MLCC 单颗消耗的烧结产能是通用低容产品的数十倍，高端产品大量挤占通用产品产能。村田 4 月已对 AI 服务器、车规级 MLCC 涨价 15%-35%，太阳诱电 5 月全线跟进，三星电机 6 月 1 日起上调消费电子 MLCC 价格。TrendForce 调研显示，部分代理商已进行预防性囤货。结合中高端产品产能扩张周期测算，行业供需缺口预计至少延续至 2028 年。

● 意法半导体：三个月内二度涨价，产业链涨价压力持续传导

5 月 28 日，意法半导体向客户发出调价通知，宣布自 6 月 28 日起对部分产品上调价格，这是继 3 月 24 日首轮涨价（4 月 26 日落地）后年内第二次调价，间隔仅约两个月。公司表示，首轮涨价后通胀压力持续，原材料、运输及人力成本进一步攀升，本轮调整主要针对此前未被涵盖的产品线。此次涨价由供给端产能约束与 AI 需求增长共同推动——成熟制程晶圆产能持续紧张，晶圆厂优先将产能分配至 PMIC、MCU 等高附加值产品，联电已规划 2026 年下半年针对性上调代工价格、2027 年大范围议价；同时 NOR 闪存涨价带来的连锁效应也已传导至 MCU 产业链。本次涨价涵盖 STM32 系列 MCU、功率 MOSFET（STP 系列）、IGBT 及 SiC 功率器件（SCT 系列）等核心品类。业内预期下半年车规、工控、AIoT 领域 MCU 需求仍将维持高位，若晶圆与存储成本无明显回落，或将有更多芯片设计企业面临成本传导压力。

● 德州仪器：7 月 1 日新价生效，模拟 IC 涨价周期确立

全球模拟 IC 龙头德州仪器于 5 月 7 日向全球代理商及直供客户正式发布调价通知，宣布自 2026 年 7 月 1 日起，所有新签订单将按调整后价格执行，主要涉及 PMIC、MOSFET 等核心产品线。此次调价标志着 TI 自 2025 年以来实施的第四轮价格调整——此前三轮分别于 2025 年 6 月、2025 年 8 月及 2026 年 4 月相继落地，其中 4 月调价幅度达 15%-85%，覆盖数字隔离器、电源管理 IC 等关键产品。TI 的连续调价行为深刻反映了模拟 IC 行业已步入确定性涨价周期。

从产业逻辑来看，AI 基础设施投资正从 GPU 算力层加速向电力基础设施层传导。随着 AI 服务器机架功率密度从传统的 10-20kW 跃升至 100kW 以上，服务器电源架构对高

压 MOSFET、IGBT 等功率器件的需求呈倍数级增长，推动模拟芯片用量与价值量同步提升。供给侧方面，LME 现货铜价于 5 月中旬攀升至 14,097 美元/吨，原材料成本持续高企；叠加晶圆代工及后段封测报价在 2026 年内接连上调，多重成本压力形成叠加效应，共同支撑模拟芯片价格的刚性上行。TI 作为全球模拟 IC 市场份额首位的行业标杆，其价格策略的持续调整对全行业具有明确的示范与引领效应。

● 英飞凌：7 月 1 日二度涨价，AI 驱动功率半导体结构性短缺

英飞凌于 5 月 26 日向客户及合作伙伴发出通知，宣布自 2026 年 7 月 1 日起调整部分产品价格。这是英飞凌继 2026 年 4 月首轮提价之后的年内第二次价格上调。英飞凌在通知中指出，由于地缘政治紧张局势，全球半导体供应链成本持续上升，涵盖能源、原材料、运输及服务各环节，同时公司产品组合的市场需求正快速增长，且增长幅度远超数月前的预期。

从市场格局来看，功率器件价格高位持稳，IGBT 单管及模块现货溢价 10%-25%，车规级 HV MOSFET 及 SiC 器件溢价最高达 30%-50%。AI 算力对功率产能形成刚性挤占——AI 数据中心高压侧用 SiC、中低压侧用 GaN、硅基 MOS，挤占晶圆产能产生溢出效应，使汽车/工业等非 AI 领域供应同步趋紧。车规、新能源及 AI 电源相关品类供不应求，供需紧平衡至少延续至 2027 年上半年。

● 恩智浦：6 月 1 日涨价落地，需求回暖但整体仍疲软

恩智浦于 5 月 1 日通知客户，自 2026 年 6 月 1 日起实施价格调整。此次调价源于不断变化的通胀性成本压力，包括原材料、能源、劳动力、物流以及供应商投入。此前恩智浦已于 4 月 1 日对部分产品实施第一轮调价。

从需求端来看，恩智浦本月需求有所回暖，但整体依旧疲软。需求较多的集中在 i.MX 系列和一些停产料。值得注意的是，恩智浦自 6 月 1 日起开始执行第二轮涨价，本次涨价主要是对 4 月份第一轮涨价的补充——4 月 1 日的涨价主要针对中小客户，大客户未涨；本轮涨价主要针对大客户，涨幅约为 10%。

● 微芯科技：8 月涨价函与看空报告并行，MCU 涨价潮全面确立

6 月 29 日，MCU 及模拟 IC 大厂 Microchip 向客户发出涨价通知函，宣布自 2026 年 8 月 14 日起对旗下部分精选产品进行价格调整，适用于所有新订单及后续出货。Microchip 表示，此次调价反映了原材料、劳动力、物流及能源成本持续上涨，以及来自供应商、封装厂及晶圆代工厂制造成本显著增加的压力。虽然公司未公布具体涨幅及产品线，但明确指出“广泛的产品系列中的各类产品都将适用这些变更”。Microchip

因产品线覆盖工业控制、汽车电子、电源管理、消费电子及物联网等几乎所有主流应用领域，被业界称为半导体业“矿坑里的金丝雀”，此次加入涨价行列被外界视为整体半导体通胀进一步定调。目前 MCU 供应严重吃紧，市场抢货状况严重，叠加德州仪器、英飞凌、恩智浦、意法半导体等国际大厂此前已先后涨价，MCU 涨价已从特定厂商行为演变为全行业趋势。

值得关注的是，J Capital Research 于 6 月同步发布针对 Microchip 的看空报告，指出其数据中心销售额仅为 3.027 亿美元，远低于 Marvell 的 40 亿美元（同比增长 88%）和博通的 200 亿美元（增幅 65%）。尽管 Microchip 预计其数据中心业务今年将实现 67% 的增长，但绝对规模仍远逊于同业竞争对手。涨价函与看空报告的同时出现，折射出 Microchip 当前面临的双重压力：一方面需通过调价传导成本以维持盈利能力，另一方面需加速数据中心等高增长领域布局以回应市场对其竞争力的质疑。不过，Microchip 强调此次涨价不会对截至 2026 年 6 月 30 日的 2026 财年第四季度业绩或此前发布的指引产生任何影响。

● 国巨：7 月 1 日起全系列电容产品涨价，被动元件涨价潮全面扩散

7 月 1 日，全球被动元件龙头国巨向客户发出价格调整通知，自当日起上调电容器解决方案全系列产品价格。此次调价范围之广前所未有，涵盖积层陶瓷电容（MLCC）、铝电解电容、钽质电容、高分子铝电容、薄膜电容及超级电容等多个品类，是国巨近年来调价范围最大的一波。据代理商透露，此次国巨电容产品原厂价格涨幅约达 50%，现货市场价格涨幅更大。值得特别关注的是，本次涨价对象首次从代理商扩展至直接客户（EMS/OEM），等同现货价与合约价同步调涨；由于直接客户占公司营收超过一半，此举预计将对国巨营收和利润产生显著提振。涉及的产品覆盖国巨约 50% 营收。

国巨董事长陈泰铭此前曾表示，下半年公司将“非常忙碌”，并持续看好 AI、汽车电子以及高阶运算等市场的发展前景。本轮涨价的深层驱动力与 MLCC 市场缺货潮一致——AI 服务器、高性能计算及电动汽车需求持续增长，推动高端被动元件量价齐升。AI 服务器机柜热设计功耗（TDP）持续攀升，尤其是英伟达 Vera Rubin 平台预计于第四季度量产，被动元件在 800V 高压直流（HVDC）电力架构中扮演日益关键的角色。被动元件已从 BOM 成本排名的底部跃升至仅次于 GPU 和存储的关键位置。中信证券认为，在国巨带动下，将有更多 MLCC 原厂落地涨价动作，本轮 MLCC 涨价周期有望延续超过一年，涨价幅度有望实现翻倍甚至翻两倍的显著提升。

● 亚德诺：Q2 财报超预期，AI 需求驱动估值持续攀升

ADI 近期公布了 2026 财年第二季度业绩，营收达 36.2 亿美元，每股收益 3.09 美元，双双超越市场预期（此前预期营收 35 亿美元、每股收益 2.92 美元）。汽车业务营收是本赛季业绩的重要支撑。

股价方面，ADI 于 6 月 22 日创历史新高，触及 442.0 美元；整个 6 月涨 7.64%，年初至今涨幅达 64.26%。市场对人工智能基础设施需求和整体供应链定价权日益增长的乐观情绪，显著提振了芯片板块的投资者情绪。从产品端来看，ADI 车规和工业隔离芯片产能优先供给新能源、工控领域，高端隔离、高速 ADC 持续交期拉长，部分型号如 ADM2587、LT1076CQ 等出现紧缺。

● 博通：携手 OpenAI 发布首款自研 AI 芯片，AI 半导体业务持续高增

6 月 25 日，OpenAI 与博通联合发布双方合作的首款定制 AI 芯片 “Jalapeño”，定位为专门服务大语言模型 “推理” 的处理器。博通与 Celestica 负责工业化落地，双方已制定多代产品路线图，计划自 2026 年底起联合微软等伙伴启动吉瓦级数据中心部署。在业绩层面，博通 AI 半导体业务 2026 财年第二季度收入达 108 亿美元，同比增长 143%。博通预计 2026 财年该业务收入将达到约 560 亿美元，而上一个财年约为 200 亿美元。不过，市场也存在一定担忧——博通在发布 Q2 财报后给出的第三财季 AI 半导体收入指引为 160 亿美元，低于分析师普遍预期的 172 亿美元。

● 瑞萨电子：收购 Pictorus 加速嵌入式系统开发战略

瑞萨电子于 6 月宣布完成对软件开发商 Pictorus 的收购。通过此次收购，瑞萨获得了一个基于云的行为建模平台，该平台可加速嵌入式系统开发，将工程体验从单一工具提升至互联的平台化模型化系统设计。

此次收购将提升瑞萨今年 3 月新发布的 “Renesas 365” 平台价值。Renesas 365 统一了从探索、开发到生命周期管理的电子系统开发全流程，使工程师能够以可视化方式设计、表达和仿真系统行为与意图。Pictorus 为工程师提供了一种在 Web 浏览器中使用框图描述行为的方法，然后对这些框图进行仿真并将其转换为可执行的嵌入式软件。这一收购标志着瑞萨正通过连续收购（Altium 和 Pictorus）在云端推出一套从 PCB 设计到算法仿真的完整工具链，用开发体验重新划定竞争边界。

● 联发科技：向客户发出正式涨价函，启动价格调整机制

供应链消息显示，联发科已向客户发出正式调价通知，由总经理暨营运长具名说明，这是该公司近年来首次以函文方式启动价格调整机制。联发科在通知中指出，全球半导体产业供应链持续面临重大挑战——前所未有的零组件短缺、产能受限、供应商交期延长，

以及原物料与物流成本上升，均导致供应成本大幅增加。此次调涨产品线涵盖手机芯片、电源管理芯片（PMIC）等多项产品，涨幅约 10%至 15%不等。联发科董事长蔡明介此前在股东会上已表示，AI 算力需求激增推动多项关键零组件进入缺货又涨价状态，联发科不排除适度调整产品价格，以转嫁越来越高的成本。业界分析认为，在 AI 服务器及高性能计算需求持续成长下，先进制程、先进封装及关键零组件资源愈趋吃紧，成本压力已逐步向 IC 设计端传导。

- **瑞昱：7 月起针对特定产品线调涨超 10%**

网通芯片大厂瑞昱将于 7 月开始针对特定产品线调涨价格，涨幅超 10%，涵盖网通、连接、消费性及部分特殊规格芯片。瑞昱受益于 Wi-Fi、以太网、交换机需求逐步改善，加上 AI PC、企业网通设备与高速传输应用带动规格升级，部分产品报价具备支撑。供应链分析指出，从晶圆代工、封测、硅晶圆乃至存储器、被动元件等价格涨势开始传导至芯片端。此前瑞昱产品主要面向消费类群体，在需求疲软情况下较不具备议价能力；但随着电源管理、驱动 IC 及部分模拟芯片供应转紧，叠加 Wi-Fi 7、AI PC 等新应用拉动高阶芯片规格升级，价格谈判主导权已逐步由买方市场转向供应端。

- **扬杰科技：年内第二轮涨价落地，欧洲市场采购资格延续**

国内功率器件 IDM 龙头扬杰科技于 6 月 23 日发布年内第二轮涨价函，宣布全系列产品（二三极管/晶闸管/MOSFET/IGBT/SiC）价格上调 10%-15%，7 月 1 日起执行。公司表示，上游晶圆、大宗金属、封装材料全线持续涨价，下半年成本增幅再度超出预期，经营承压加剧。值得关注的是，扬杰科技于 4 月被欧盟列入相关名单后，经欧洲产业客户联合呼吁，6 月获欧盟理事会授予 9 个月过渡期（至 2027 年 3 月 16 日），欧洲客户在此期间仍可继续采购其关键零部件——这折射出欧洲汽车制造商对中国功率器件供应链的高度依赖，短期内难以找到完全替代的二级供应源。从市场格局看，AI 服务器电源功率从 800W 跃升至 5.5kW 以上，单台服务器功率器件价值从 6-7 美元升至 30-50 美元，直接拉动 MOSFET、IGBT、SiC 用量激增。扬杰科技凭借自有晶圆产能在供给紧张周期中具备更强产能保障能力，本轮涨价既缓解成本压力，也进一步巩固其在车规、工控及 AI 电源市场的战略地位。

- **台积电/英伟达：GTC Taipei 宣布 AI 深度合作，黄仁勳亲赴 COMPUTEX 释放多重信号**

6 月 1 日，台积电与英伟达在 GTC Taipei 大会上联合宣布了一项里程碑式战略合作——台积电正将英伟达的加速计算和 AI 技术全面引入晶圆厂生产流程，从计算光刻、晶

体管仿真到缺陷检测和工厂运营，系统性提升先进制造效率与良率。台积电借助英伟达 CUDA-X 库及 PhysicsNeMo 框架加速芯片仿真和光刻计算 workflow，同时利用 Omniverse 和 cuOpt 构建晶圆厂数字孪生，推动工厂自主化运营，光刻成本预计可降低 50%。当前台积电 3nm 制程产能持续满载，即便月产能从 13 万片扩至 16–17.5 万片，仍无法满足 NVIDIA、AMD、Google、AWS 等客户排队订单，涨价趋势至少贯穿 2026 下半年至 2027 年。英伟达 CEO 黄仁勳亲赴中国台湾出席 COMPUTEX 2026 及 GTC Taipei，他在演讲中公开表示 Marvell 有望成为下一个万亿美元公司，受此提振 Marvell 盘前股价大涨逾 25%；此前黄仁勳在首尔与 SK 集团董事长崔泰源会晤后确认，英伟达即将推出的 Vera CPU 将采用 SK 海力士内存芯片。这一系列动作进一步强化了由英伟达、SK 海力士与台积电组成的“AI 半导体三角联盟”在全球供应链中的关键地位，标志着英伟达正从 AI 芯片设计端延伸至半导体制造核心环节，构建“AI 设计芯片、芯片运行 AI”的完整闭环生态。

● 晶圆代工行业：全面进入涨价上行周期

TrendForce 于 6 月 8 日发布的晶圆代工市场快讯显示，台积电、联电、世界先进与力积电等台系晶圆代工厂因产能供不应求，2026 年下半年起陆续推动涨价，且涨幅有望延续至 2027 年，整体代工报价进入上行周期。

联电财务长刘启东在股东大会上表示，公司规划 2026 下半年针对性上调代工价格，2027 年将与客户开展大范围议价。联电股价一度狂飙至 170 元，强势改写自 2000 年以来的 26 年新高。世界先进董事长暨策略长方略则表示，公司已有宣布涨价措施并得到客户大部分接受与了解，预期下半年价格仍有支撑。晶圆代工成熟制程产能供不应求，叠加生产成本持续垫高，成为推动下游芯片厂商涨价的根本动力之一。

三、终端市场动态

终端市场动态概览		
类别	动态	洞察
人工智能	Meta 正探索筹集数百亿美元资金, 以支持 AI 基础设施扩建, 进一步推动其长期人工智能发展战略	持续扩大 AI 基础设施投资, 预计将带动 AI 服务器、企业级存储、高速网络设备及高性能存储器等产品需求。
	Amazon Web Services (AWS) 宣布将额外投资 130 亿美元, 扩建印度的 AI 及云端基础设施。	随着超大型云端基础设施持续扩张, 预计将带动 AI 服务器、企业级 SSD、DDR5 存储器、网络设备及电力基础设施等产品的采购需求。
	腾讯向长鑫存储 (CXMT) 下达了一笔价值超过 200 亿元人民币 (约 30 亿美元) 的长期服务器 DRAM 采购订单, 以支持其不断扩展的云计算和人工智能 (AI) 基础设施。	随着 AI 算力需求不断提升, 预计将进一步带动企业级存储器、AI 服务器、存储系统及支撑大规模 AI 部署的云端基础设施采购需求。
汽车	BMW 集团进一步扩大与 Figure AI 的合作, 在斯帕坦堡工厂导入 Figure 03 人形机器人参与生产作业。	持续加码电动车制造投资, 预计将带动汽车微控制器 (MCU)、电池管理 IC、碳化硅 (SiC) 功率元件、车规级存储器及传感器等汽车电子元件的需求。
	比亚迪 (BYD) 计划透过持续拓展全球市场及扩大电动车产能, 在未来五年内成为全球最大的汽车制造商。	其长期成长策略有望进一步带动汽车微控制器 (MCU)、电力半导体、电池管理 IC 及车载连接解决方案的市场需求。
	Jeep 宣布计划于 2030 年前将欧洲产品阵容扩展至六款车型, 包括全新混合动力车及纯电动车, 以进一步强化其在欧洲市场的竞争力	持续推进电动化产品布局, 预计将带动汽车微控制器 (MCU)、电池管理 IC、电力半导体、车载连接模组及车规级存储器等汽车电子元件的长期需求。
工业	霍尼韦尔宣布计划投入 20 亿至 40 亿美元进行并购, 并将工业自动化列为企业重组后的重点投资方向之一。	持续加码工业自动化投资, 预计将带动工业控制器、PLC、传感器、电力电子及工厂自动化系统等相关需求增长。
	施耐德电气宣布将以约 31 亿美元收购工业 AI 软件公司 Cognite, 进一步强化其工业数字化产品布局。	此次收购将进一步推动工业 AI 应用普及, 并有望带动工业网络、边缘计算、自动化控制器及智能感测技术等相关需求增长。
	埃森哲扩大与西门子的合作, 加速全球制造企业导入软件定义制造及工业 AI。	随着工业软件及 AI 应用日益普及, 预计将带动工业 PC、连接模块、嵌入式处理器及自动化基础设施等需求持续增长。
	西门子升级工业软件产品组合, 进一步推动软件定义自动化及 AI 驱动工程设计的不断发展。	制造业数字化转型持续深化, 预计将为工业控制器、边缘计算、传感器及工业通信模块等相关产品带来更多市场机会。

机器人	Appttronik 启用全新的 Robot Park, 并发布 Apollo 2 人形机器人, 以加速真实工作场景训练及商业化部署。	人形机器人训练与部署基础设施的持续扩建, 预计将带动嵌入式计算平台、机器视觉系统、运动控制器、传感器及工业级存储器等需求增长。
	宇树科技 (Unitree Robotics) 持续推进首次公开募股 (IPO) 计划, 并持续扩大人形机器人产能, 反映尽管市场竞争日益激烈, 商业机器人市场的发展动能依然强劲。	随着人形机器人制造投资持续增加及商业化进程加速, 预计将带动运动控制 IC、嵌入式处理器、机器视觉系统、工业级存储器及高精度传感器等关键零组件的需求。
	Agility Robotics 宣布将通过与 SPAC 合并上市, 支持公司下一阶段的商业化扩张及制造产能提升。	随着资金投入增加及商业化进程加快, 预计将推动伺服驱动器、嵌入式处理器、机器视觉系统、工业级存储器及电源管理元件等采购需求持续增长。

（一）人工智能

● Meta 寻求新融资以扩建 AI 基础设施

Meta 正探索筹集数百亿美元资金，以支持 AI 基础设施扩建，并为未来数据中心及 AI 算力建设提供资金支持。此举反映在超大型云服务业者（Hyperscalers）竞争日益激烈的背景下，Meta 持续强化人工智能能力的长期布局。随着 AI 基础设施投资持续扩大，预计将进一步带动 AI 服务器、企业级存储、高速网络设备及高性能存储器等产品需求，并推动整体 AI 基础设施持续扩展。

● AWS 加码投资印度 AI 及云端基础设施

Amazon Web Services (AWS) 宣布额外投资 130 亿美元，扩建印度 AI 及云端基础设施。此次投资旨在提升区域云端服务能力，并支持当地企业对 AI 服务日益增长的采用需求。随着超大型云端基础设施持续扩张，云服务业者不断提升 AI 就绪 (AI-ready) 算力部署，预计将带动 AI 服务器、企业级 SSD、DDR5 存储器、网络设备及电力基础设施等产品需求。

● 腾讯向长鑫存储下达 200 亿元 DRAM 订单

腾讯向长鑫存储 (CXMT) 下达了一笔价值超过 200 亿元人民币（约 30 亿美元）的长期服务器 DRAM 采购订单，以支持其云计算和 AI 基础设施扩张。此举反映腾讯对高性能内存需求持续增长，并进一步加强与国内存储厂商的合作。随着 AI 和云计算持续发展，企业级 DRAM 及 AI 服务器等相关需求预计将保持强劲。

(二) 汽车

● BMW 完成在美国的 17 亿美元电动车生产投资

宝马已完成对其南卡罗来纳州工厂的 17 亿美元投资,用于在美国本土建立全面电动车生产能力。该投资进一步强化了宝马在电动车制造领域的布局,并支持其未来在北美市场生产新一代电动车型。此次产能扩张预计将带动汽车 MCU、碳化硅 (SiC) 与 IGBT 功率器件、电池管理 IC、车规存储器、传感器、MLCC 以及功率电感等需求增长。随着电动车产量持续扩大,汽车电子元器件的整体需求预计将保持强劲。

● 比亚迪瞄准全球最大汽车制造商地位

比亚迪宣布,公司目标是在未来五年内成为全球最大的汽车制造商,并将持续推动海外市场扩张及提升电动车产能,以实现这一战略目标。此举反映公司对全球电动车长期需求保持高度信心。随着产能持续增长,预计将进一步带动电动车供应链对汽车微控制器 (MCU)、电池管理 IC、电力半导体、车载连接模组及车规级存储器等关键汽车电子元件的需求。

● Jeep 扩大欧洲电动化布局

Jeep 宣布,计划于 2030 年前将欧洲产品阵容扩展至六款车型,其中包括全新混合动力车 (Hybrid) 及纯电动车 (BEV)。此策略旨在强化 Jeep 在欧洲市场的竞争力,同时配合 Stellantis 集团整体电动化发展路线,并满足欧洲消费者不断变化的市场需求。产品阵容的持续扩充,进一步彰显汽车产业对电动化发展的长期承诺。随着混合动力及纯电动车平台持续推出,预计将带动汽车微控制器 (MCU)、电池管理 IC、电力半导体、车载连接模组及车规级存储器等汽车电子元件需求增长,并为整体汽车电子供应链创造更多发展机会。

(三) 工业

● 霍尼韦尔瞄准工业自动化领域并购机会

霍尼韦尔宣布，计划投入 20 亿至 40 亿美元进行并购，并将工业自动化列为公司完成业务重组后的重点投资方向之一。公司希望进一步强化自动化产品组合，以把握制造业持续推进数字化转型及智慧工厂建设所带来的市场机会。该策略反映出公司在宏观经济环境仍存在不确定性的情况下，依然看好工业自动化的发展前景。随着自动化投资持续增加，预计将带动工业控制器、PLC、传感器、电力电子及工厂自动化设备等相关需求增长。

● 施耐德电气拟以 31 亿美元收购 Cognite

施耐德电气宣布，将以约 31 亿美元收购工业 AI 软件公司 Cognite，以强化其在工业数据管理、数字孪生及 AI 驱动自动化领域的的能力。此次收购进一步扩充施耐德电气的软件产品组合，并支持其长期工业数字化发展战略。此举反映工业 AI 在制造业及能源产业的应用持续扩大，预计将进一步带动工业网络、边缘计算、自动化控制器、传感器及智能监测系统等智慧工厂相关解决方案的需求增长。

● 埃森哲扩大与西门子的工业 AI 合作

埃森哲进一步扩大与西门子的合作，协助制造企业加速推动软件定义制造 (Software-Defined Manufacturing) 及工业 AI 的应用。双方将结合西门子的工业软件平台与埃森哲的数字工程专业能力，以提升生产效率及工厂运营效能。随着软件定义制造逐渐普及，预计将带动工业 PC、嵌入式处理器、连接模块、自动化平台及工厂通信基础设施等相关需求持续增长。

● 西门子推进软件定义工业自动化发展

西门子宣布升级其工业软件产品组合，进一步支持软件定义自动化、AI 辅助工程设计

及 IT/OT（信息技术 / 运营技术）融合。相关更新旨在帮助制造企业提升工程效率，并加快数字化转型进程。随着软件驱动制造持续发展，预计将进一步带动工业控制器、边缘计算平台、工业通信模块、传感器及自动化相关电子元件等需求增长。

（四）机器人

- **Appttronik 启用 Robot Park，并发布 Apollo 2 人形机器人**

Appttronik 正式启用占地 9 万平方英尺的 Robot Park，并发布新一代人形机器人 Apollo 2，旨在加速机器人训练，并推动其在制造、物流及仓储等领域的商业化应用。该设施可让机器人在接近真实工业场景的环境中完成训练，再部署至客户现场。此次投资反映出市场对商用人形机器人发展的信心已逐步从原型验证迈向实际应用。随着人形机器人部署持续扩大，预计将逐步带动嵌入式计算平台、机器视觉系统、运动控制器、工业传感器、高性能处理器及工业级存储器等下一代机器人核心电子元件的需求增长。

- **宇树科技持续推进 IPO 计划并扩大人形机器人产能**

宇树科技（Unitree Robotics）持续推进首次公开募股（IPO）计划，并同步扩大人形机器人产能，反映市场投资者对中国机器人产业的关注度持续提升。尽管市场竞争日益激烈且商业化仍面临挑战，公司仍专注于提升制造能力，并巩固其在人形机器人市场快速发展的竞争地位。此项发展凸显商业机器人领域投资持续增长，随着制造商加速量产新一代人形机器人，预计将带动运动控制 IC、嵌入式处理器、机器视觉系统、工业级存储器及高精度传感器等关键零组件的需求。

- **Agility Robotics 计划通过 SPAC 合并上市**

Agility Robotics 宣布将通过与特殊目的收购公司（SPAC）合并的方式上市，公司估值约为 25 亿美元。此次交易预计将为公司提供更多资金，用于加速人形机器人的商业化部署、扩大制造产能及推进产品研发，以满足持续增长的市场需求。此次上市反映出

投资者对人形机器人商业化前景的信心不断提升。随着资金到位及产能持续扩张，预计将进一步带动伺服驱动器、嵌入式处理器、机器视觉系统、工业级存储器、运动控制电子元件及电源管理元件等相关需求增长。

四、存储行情

(一) 存储行情概览

- **DDR4**：供应持续收紧，价格高位运行，整体稳中偏强。
- **DDR5**：需求旺盛叠加供给不足，合约价连续多月大涨，市场处于供不应求状态。
- **LPDDR5**：价格高位，移动端承压。
- **NAND Flash**：二季度合约价预计大幅上涨，NOR Flash、SLC NAND 上半年涨幅均超一倍。
- **SSD**：终端零售价较年初大幅攀升，铠侠推出 PCIe 5.0 高端新品。
- **HDD**：批发价连续第五季度上涨，均价相较基准已翻倍，涨势未见放缓。

(二) 各存储品牌现货市场价格走势

6月三星 Samsung

品类	规格	价格走势	品类	规格	价格走势
DDR4 颗粒	16Gb(1G*16)	持平	DDR4	64GB(服务器)	持平
	16Gb(2G*8)	+30.67%		32GB(服务器)	+10.00%
	8Gb(512*16)	+30.00%		16GB(服务器)	持平
	8Gb(1G*8)	持平		32GB(PC)	持平
	4Gb(256*16)	+25.00%		16GB(PC)	持平
	4Gb(512*8)	+21.43%		8GB(PC)	-5.56%
				4GB(PC)	持平

品类	规格	价格走势	品类	规格	价格走势
DDR5	96GB(服务器)	持平	SSD	7680GB/7.68TB（企业级）	持平
	64GB(服务器)	+28.00%		3840GB/3.84TB（企业级）	持平
	32GB(服务器)	+33.33%		1920GB/1.92TB（企业级）	持平
	16GB(服务器)	+15.38%		960GB/1TB（企业级）	持平
	32GB（PC）	-4.44%		480GB（企业级）	持平
	16GB（PC）	持平		240GB（企业级）	持平
	8GB（PC）	+6.67%		2TB（消费级）	持平
				1TB（消费级）	持平
				512GB（消费级）	持平

品类	规格	价格走势
NAND flash	1Gb-SLC	+3.82%
	2Gb-SLC	+2.50%
	4Gb-SLC	+15.38%
	8Gb-SLC	+7.04%
	16Gb-SLC	+29.63%

SK 海力士 SK Hynix

品类	规格	价格走势	品类	规格	价格走势
DDR4 颗粒	16Gb(1G*16)	+16.67%	DDR4	64GB(服务器)	持平
	16Gb(2G*8)	+53.85%		32GB(服务器)	持平
	8Gb(512*16)	+52.17%		16GB(服务器)	持平
	8Gb(1G*8)	持平		32GB (PC)	持平
	4Gb(256*16)	+55.56%		16GB (PC)	持平
				8GB (PC)	持平
				4GB (PC)	持平

品类	规格	价格走势
DDR5	96GB(服务器)	+2.56%
	64GB(服务器)	+28.00%
	32GB(服务器)	+33.33%
	16GB(服务器)	+15.38%
	32GB (PC)	持平
	16GB (PC)	持平
	8GB (PC)	持平

品类	规格	价格走势
NAND flash	1Gb-SLC	+3.03%
	2Gb-SLC	+4.17%
	4Gb-SLC	+6.15%

美光 Micron

品类	规格	价格走势	品类	规格	价格走势
DDR4 颗粒	16Gb(1G*16)	+7.69%	DDR4	64GB(服务器)	持平
	16Gb(2G*8)	+32.00%		32GB(服务器)	持平
	8Gb(512*16)	+75.00%		16GB(服务器)	持平
	8Gb(1G*8)	+27.27%		32GB(PC)	持平
				16GB(PC)	持平
				8GB(PC)	持平
				4GB(PC)	持平

品类	规格	价格走势	品类	规格	价格走势
DDR5	96GB(服务器)	持平	SSD	7680GB/7.68TB（企业级）	持平
	64GB(服务器)	+8.70%		3840GB/3.84TB（企业级）	持平
	32GB(服务器)	持平		1920GB/1.92TB（企业级）	持平
	16GB(服务器)	持平		960GB/1TB（企业级）	持平
	32GB（PC）	持平		480GB（企业级）	+30.00%
	16GB（PC）	持平		240GB（企业级）	+39.39%
	8GB（PC）	持平			

品类	规格	价格走势
NAND flash	1Gb-SLC	+4.55%
	2Gb-SLC	+4.29%
	4Gb-SLC	+12.90%
	8Gb-SLC	+5.00%

南亚 Nanya

品类	规格	价格走势
DDR4 颗粒	8Gb(512*16)	+66.67%
	8Gb(1G*8)	+38.30%
	4Gb(256*16)	+27.27%

铠侠 KIOXIA

品类	规格	价格走势
NAND flash	1Gb-SLC	-2.35%
	2Gb-SLC	+6.67%
	4Gb-SLC	+15.15%
	8Gb-SLC	+4.84%
	16Gb-SLC	+23.21%

旺宏 MXIC

品类	规格	价格走势
NAND flash	1Gb-SLC	+12.50%
	2Gb-SLC	+4.62%
	4Gb-SLC	+11.11%

华邦 Winbond

品类	规格	价格走势
NAND flash	1Gb-SLC	+31.25%
	2Gb-SLC	+30.77%
	4Gb-SLC	+47.73%

英睿达 Crucial

品类	规格	价格走势	品类	规格	价格走势
DDR4	32GB (PC)	-16.67%	DDR5	32GB (PC)	-5.00%
	16GB (PC)	-5.88%		16GB (PC)	-13.04%
	8GB (PC)	持平		8GB (PC)	持平

金士顿 Kingston

品类	规格	价格走势	品类	规格	价格走势
DDR4	64GB(服务器)	+10.76%	DDR5	96GB（服务器）	+2.27%
	32GB(服务器)	+28.57%		64GB（服务器）	+4.44%
	16GB(服务器)	+10.94%		32GB（服务器）	+9.26%
	32GB（PC）	+5.48%		16GB（服务器）	+10.34%
	16GB（PC）	持平		32GB（PC）	+5.00%
	8GB（PC）	持平		16GB（PC）	+4.35%
				8GB（PC）	+26.09%

西数 WD

品类	规格	价格走势
HDD	24TB（企业级）	持平
	20TB（企业级）	持平
	18TB（企业级）	持平
	16TB（企业级）	持平
	8TB（企业级）	持平

希捷 Seagate

品类	规格	价格走势
HDD	24TB（企业级）	持平
	20TB（企业级）	持平
	18TB（企业级）	持平
	16TB（企业级）	持平
	8TB（企业级）	持平

东芝 Toshiba

品类	规格	价格走势
HDD	24TB（企业级）	持平
	20TB（企业级）	持平
	18TB（企业级）	持平
	16TB（企业级）	持平
	8TB（企业级）	持平

以上价格数据截至 2026 年 6 月，受市场供需影响，价格浮动明显，价格走势仅作参考

信息来源

- [1] Bloomberg. "TSMC Starts Work on Third Arizona Chip Plant to Boost US Output." Bloomberg, May 2026
- [2] Broadcom. "OpenAI Unveils First Custom-Designed AI Chip 'Jalapeno'." Khaleej Times, June 25, 2026.
- [3] China AET. "MCU 大厂 Microchip 宣布涨价！" China AET (芯智讯), July 1, 2026.
- [4] EU Commission. "European Technological Sovereignty Package: Chips Act 2.0 and Cloud and AI Development Act." European Commission, June 3, 2026
- [5] Federal Reserve. "FOMC Statement and Economic Projections." Federal Reserve, June 17, 2026.
- [6] Investing.com. "United States 10-Year Bond Yield Historical Data." Investing.com, accessed June 2026.
- [7] J.P.Morgan and S&P Global. "Global Manufacturing PMI – May 2026." J.P.Morgan & S&P Global Market Intelligence, May 2026.
- [8] RatingDog. "China General Manufacturing PMI – May 2026." RatingDog, May 2026.
- [9] Reuters. "Japanese Government Aims for 370 Trillion Yen Investment in 17 Strategic Sectors by 2040." Reuters, June 20, 2026.
- [10] Reuters. "Dutch Minister Presses U.S. Lawmakers over China Chip Export Bill." Reuters, June 23, 2026.
- [11] Reuters. "Exclusive: U.S. Commerce Department Pauses Adding 75 Chinese Semiconductor and AI Firms to Entity List." Reuters, June 16, 2026.
- [12] Reuters. "U.S. Senators Urge Tougher Rules on TSMC and Chip Foundries to Block Chinese Firms from Accessing Advanced Chips via Overseas Units." Reuters, June 8, 2026.
- [13] Renesas Electronics. "Renesas Acquires Pictorus to Simplify and Accelerate Embedded Application Software Development." Renesas Electronics, June 16, 2026.
- [14] S&P Global. "Eurozone Manufacturing PMI – May 2026." S&P Global, May 2026.

- [15] S&P Global. "Japan Manufacturing PMI – May 2026." S&P Global, May 2026.
- [16] S&P Global. "South Korea Manufacturing PMI – May 2026." S&P Global, May 2026.
- [17] S&P Global. "US Manufacturing PMI – May 2026." S&P Global, May 2026.
- [18] Semiconductor Industry Association (SIA). "Global Semiconductor Sales Increase 11% Month-to-Month in April." SIA, June 5, 2026.
- [19] S&P Global and HSBC. "India Manufacturing PMI – May 2026." S&P Global and HSBC, May 2026.
- [20] Securities Times. "MLCC 龙头又涨价了." 上海证券报·中国证券网, July 1, 2026.
- [21] Securities Times. "国巨电容涨价 机构预计更多 MLCC 原厂将跟进." 上海证券报, July 2, 2026.
- [22] SECCW. "Microchip 发出涨价函, 8 月中起调涨 MCU 报价." SECCW (经济日报), July 3, 2026.
- [23] TrendForce. "[News] Passive Component Prices Rise as YAGEO Reportedly Begins Broadest Capacitor Hike in Years on July 1." TrendForce, July 1, 2026.
- [24] The Philadelphia Stock Exchange. "PHLX Semiconductor Sector Index (SOX) Historical Data." NASDAQ, accessed June 2026.
- [25] TrendForce. "[News] STMicroelectronics Reportedly Set for Second MCU Price Hike This Year, Effective June 28." TrendForce, June 23, 2026.
- [26] World Semiconductor Trade Statistics (WSTS). "WSTS Spring 2026 Global Semiconductor Sales Forecast." WSTS, June 2026.
- [27] 中国政府网. "工业和信息化部印发《‘人工智能+信息通信’创新发展实施意见（2026—2028 年）》." 中国政府网, 2026 年 6 月 10 日.
- [28] 集邦化合物半导体. "韩国投 22.3 亿元攻关下一代功率半导体." 集邦化合物半导体, 2026 年 6 月.
- [29] China Times. "大缺货 陆 MLCC 報價波動劇烈." China Times, June 25, 2026.
- [30] EET China. "意法半导体 6 月 28 日再调价, MCU/功率芯片全行业'涨'声一"

片。” EET China, June 1, 2026.

[31] EET China. “瑞萨收购 Pictorus, 提升 Renesas 365 价值。” EET China, June 22, 2026.

[32] EET China. “消息称瑞昱、联发科将对部分成熟制程产品涨价。” EET China, June 22, 2026.

[33] First Finance. “实探华强北：目前 MLCC 行业涨价集中在高端领域 中低容产品交货周期延长。” Shanghai Securities News, June 16, 2026.

[34] First Finance. “还在涨价！半小时报一次价！'电子工业大米'价格涨势胜黄金。” First Finance, June 24, 2026.

[35] Investing.com. “亚德诺半导体业绩超预期，第三季度指引亦高于市场预期。” Investing.com, May 20, 2026.

[36] Investing.com. “Microchip Technology 股价下跌，J Capital Research 发布看空报告。” Investing.com, June 24, 2026.

[37] Jiemian News. “扬杰科技：全系列产品价格上调 10%-15%，7 月 1 日执行。” Jiemian News, June 23, 2026.

[38] New Electronics. “STMicroelectronics Expected to Implement Second MCU Price Increase in 2026.” New Electronics, June 24, 2026.

[39] PingWest. “OpenAI 携手博通发布首款智能处理器 Jalapeño。” PingWest, June 25, 2026.

[40] SECCW. “多轮连涨开启！全球模拟厂商 7 月纷纷提价。” SECCW, June 24, 2026.

[41] Sina Finance. “ANALOG DEVICES INC(ADI)FY26Q2 业绩点评及业绩说明会纪要：数据中心需求强劲汽车持续复苏 收入及 EPS 均超指引上限。” Sina Finance, May 25, 2026.

[42] TrendForce. “MCU 巨头意法半导体年内二次涨价。” TrendForce, June 1, 2026.

[43] TrendForce. “晶圆代工 (Foundry) 市场快讯。” TrendForce, June 8, 2026.

[44] Xincal.com. “AI 热潮蔓延至电源芯片，英飞凌宣布 7 月起再度提价。” Xincal.com, May 27, 2026.

[45] 163.com. “涨价函继续！又有芯片巨头宣布涨价！半年涨价两次！” 163.com, May 10, 2026.

[46] 财联社. “全线涨价！国内功率器件头部企业，官宣二度调价。” 财联社, June

23, 2026.

[47] 工商时报. “一封漲價函點火！聯發科、瑞昱同步調價 IC 設計股嗨翻.” 工商时报, June 23, 2026.

[48] 集微网. “意法半导体年内二度上调 MCU 产品价格，6 月 28 日起正式执行.” 集微网 (DRAMeXchange), June 24, 2026.

[49] 界面新闻. “扬杰科技：全系列产品价格上调 10%-15%，7 月 1 日执行.” 界面新闻, June 23, 2026.

[50] 科技新报. “英飞凌宣布涨价：7 月 1 日生效!” 科技新报 (ICSmart), May 28, 2026.

[51] 快科技. “多轮连涨开启！全球模拟芯片 7 月集体涨价.” 快科技, June 24, 2026.

[52] 证券之星. “股市必读：扬杰科技（300373）6 月 22 日董秘有最新回复.” 证券之星, June 23, 2026.

[53] 中时新闻网. “大缺貨 陸 MLCC 報價波動劇烈.” 中时新闻网, June 25, 2026.

[54] Amazon Web Services. “Amazon Commits US\$13 Billion to Expand AI and Cloud Infrastructure in India.” June 2026.

[55] AgiBot. “AgiBot Reaches 15,000 Humanoid Robot Production Milestone.” July 2026.

[56] Reuters Breakingviews. “Unitree Previews China's Bleak Robot Reality.” June 11, 2026.

[57] Business Insider. “Agility Robotics to Go Public Through SPAC Merger at US\$2.5 Billion Valuation.” June 2026.

[58] Canon Medical Systems Europe. “Canon Medical Newsroom.” June 2026.

[59] EVMagz. “BMW Completes US\$1.7 Billion South Carolina Expansion Ahead of U.S.-Built iX5.” June 2026.

[60] GE HealthCare. “GE HealthCare Expands AI-Enabled Nuclear Medicine Ecosystem.” June 2026.

[61] Honeywell. “Honeywell Targets US\$2 Billion–US\$4 Billion Industrial Automation Acquisitions.” June 11, 2026.

[62] MarketScale. “Automation Industry Roundup: Sensors, Software and AI Drive June 2026 Product Wave.” June 2026.

[63] Philips. “Future Health Index 2026: AI Is Already Saving Clinicians Time

and Delivering Measurable Impact in Healthcare.” June 2026.

[64] Reuters. “Appttronik Launches Robot Training Hub and Unveils Apollo 2 Humanoid Robot.” June 30, 2026.

[65] Reuters. “BYD Chairman Says Firm Will Be World's Biggest Automaker in Five Years.” June 10, 2026.

[66] Reuters. “China's CXMT Wins US\$3 Billion Memory Supply Deal with Tencent, Sources Say.” June 29, 2026.

[67] Reuters. “Jeep Plans Six-Model Range in Europe by 2030, Including China-Built Large SUV.” June 29, 2026.

[68] Reuters. “Meta Weighs Big Equity Raising to Finance AI Infrastructure, FT Reports.” June 5, 2026.

[69] Reuters. “Schneider Electric to Buy AI Software Firm Cognite for US\$3.1 Billion.” June 30, 2026.

[70] Reuters. “Honeywell Targets US\$2 Billion – US\$4 Billion Deals, Eyes Industrial Automation M&A.” June 11, 2026.

[71] StockTitan. “Accenture to Strengthen Capabilities for Software and Automation.” June 2026.

[72] TrendForce, 上半年合約價漲幅皆破 100%，2H26 結構性缺貨將帶動 NOR Flash、SLC NAND 價格持續上漲，2026.6.16

[73] 中关村在线，存储市场价格持续飙升：内存涨 288%、机械硬盘翻倍、SSD 涨 112%，2026.6.17

[74] 鎧俠，鎧俠於 PCIe® 5.0 個人儲存 SSD 產品線推出全新 4TB 大容量，2026.6.16

[75] 快科技，LPDDR5X 单季价格狂飙 89% 手机和 PC 的涨价潮还在后头，2026.6.23

[76] 半导铁盒 IC-BOX，每周存储市场行情监测，2026.6.27

免责声明

安芯易电子商务（深圳）有限公司(下称“安芯易公司”)所发布的月度报告由安芯易公司市场部基于现已公开的资料、信息、研究报告等进行整理编制而成。

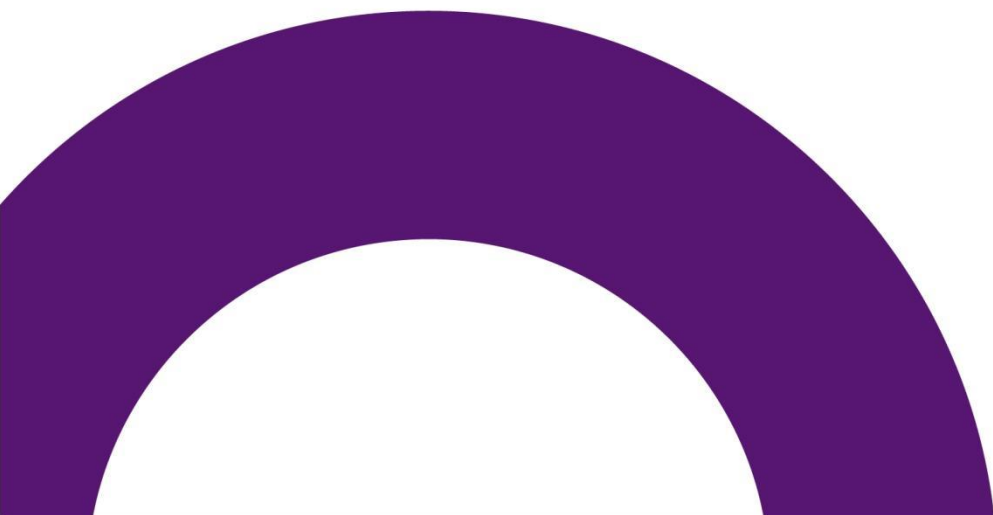
本报告所载的资料、意见及推测仅反映安芯易公司在报告发布当期的判断、观点，仅供学习参考之用，不构成对所述产品的出价、征价、要约或要约邀请，不构成任何合同或承诺的基础，不构成买卖任何投资工具或者达成任何交易的推荐，亦不构成任何投资、采购及其他应用建议和指导，对任何因直接或间接使用本报告涉及的信息和内容或者据此进行交易、投资所造成的一切后果或损失，安芯易公司不承担任何法律责任。因此，读者在阅读本报告时应保持警惕，并进行独立的判断和分析。

安芯易公司对本报告中所引用的资料、研究报告所涉及的或从第三方媒体获得的信息及数据的真实性、准确性、完整性和及时性不作任何明示或默示的保证。所发布的信息、观点以及数据有可能因发布日之后的情势或其他因素的变更而不再准确或失效，但安芯易公司不承担更新不准确或过时的信息、观点以及数据的义务，在对相关信息进行变更或更新时亦不会另行通知。

该报告版权归安芯易公司及相关内容提供方所有，未经授权，任何人不得以任何方式转载、修改、翻版、分发、复制、发表。

安芯易电子商务（深圳）有限公司

2026 年 6 月



安芯易隶属于Ample Solutions集团,成立于2008年,在全球拥有8个办公室,专注于为全球电子制造业客户提供元器件全球采购及供应链服务。我们始终秉持“专注、专业、坚韧、谦卑”的核心价值观,为客户提供卓越服务,助力客户成功。

我们拥有100+资深采购专家,并与来自全球的10000+供应商建立合作,致力于以更快的速度,更低的成本,为客户解决元器件供应链问题。

在深圳和香港,我们建立了两个高标准品质控制中心,严格遵循国际品质控制体系。从供应商管理到品质检测,全方位地防范风险,确保客户的元器件供应链安全和稳定。

